



**5.1 重要提示**  
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 1.2 公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2010年度财务报告审计机构，注册会计师签字并加盖公章。  
 1.3 公司负责人陈瑞生、主管会计工作负责人陈瑞生及会计机构负责人、会计主管人员 寇宗坤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**5.2 基本情况简介**  
 5.2.1 基本情况简介

股票简称	中瑞思创
股票代码	300078
法定代表人	陈瑞
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系方式	联系地址	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈武军	陈武军	潘晓勤
联系地址	杭州市莫干山路1418-25号(上城科技产业园)	杭州市莫干山路1418-25号(上城科技产业园)	杭州市莫干山路1418-25号(上城科技产业园)
电话	0571-28818665	0571-28818665	0571-28818665
传真	0571-28818665	0571-28818665	0571-28818665
电子邮箱	zhongruo@century-cn.com	zhongruo@century-cn.com	zhongruo@century-cn.com

2.3 主要财务数据和指标	2.3.1 主要会计数据		
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	170,126,665.56	141,349,338.45	20.36%
营业利润(元)	54,856,466.93	47,857,562.88	14.62%
利润总额(元)	55,216,322.15	48,808,227.45	14.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,546,636.32	39,873,937.96	19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,663,088.96	38,916,402.03	19.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,784,175.10	26,906,593.08	-17.07%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,155,455,816.60	1,206,507,041.40	-4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,114,785,735.16	1,167,747,695.22	-4.54%
股本(元)	167,500,000.00	67,000,000.00	150.00%

2.3.2 主要财务指标	单位:元		
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.72	-61.11%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.72	-61.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.70	-60.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.11%	8.46%	-4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.03%	8.25%	-4.22%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.40	-87.50%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6.66	17.43	-61.79%

2.3.3 非经常性损益项目	单位:元		
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,286,400.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,100.00	-	-
所得税影响额	44,167.48	-	-
非流动资产处置损益	-155,920.12	-	-
合计	883,547.36	-	-

5.3 董事会报告	5.3.1 主营业务、产品或服务情况					
产品/服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
集成电路	12,349.35	7,837.96	36.59%	16.79%	28.87%	-5.95%
封装基板	3,074.35	1,732.98	43.63%	32.96%	55.15%	-8.07%
封装材料	1,392.75	990.81	28.60%	11.84%	45.03%	-16.28%
其他	158.87	81.27	48.84%	-	-	-

3.2 营业分部地区情况	单位:万元	
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	16,290.20	19.18%
国外销售	685.13	48.01%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明	不适用
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明	不适用
3.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析	不适用
3.6 无形资产、商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权发生重大变化的影响及重大不利变化的原因分析	不适用
3.7 报告期内资产减值准备计提、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司采取的措施	不适用
3.8 募集资金使用情况	不适用
3.8.1 募集资金使用计划对照表	不适用

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-

募集资金总额	94,088.29	本报告期投入募集资金总额	1,862.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,739.59
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子产品的封装材料封装及RFID芯片封装项目	否	9,829.00	9,829.00	1,596.69	3,989.16	2012年04月26日	40.59%	0.00	不适用
电子产品的封装材料封装技术改造项目	否	7,346.00	7,346.00	265.33	1,750.43	2012年04月26日	24.16%	0.00	不适用
封装材料项目小计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-
合计	-	-17,075.00	-17,075.00	1,862.02	5,739.59	-	-	0.00	